

公司代码：603005

公司简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度公司的利润分配方案为：以公司目前总股本339,344,764股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币2.35元（含税），共计人民币79,746,019.54元，同时以未分配利润向全体股东每10股送1股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计送、转股67,868,952股，送转股后公司总股本为407,213,716股。本预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	吉冰沁
办公地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电话	0512-67730001	0512-67730001
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

2 报告期公司主要业务简介

- (1) 主营业务：公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，

同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线，涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D 传感等电子领域。

(2) 经营模式：公司所处封装行业的经营模式主要分为两大类：一类是 IDM 模式，由国际 IDM 公司设立的全资或控股的封装厂，作为集团的一个生产环节，实行内部结算，不独立对外经营；另一类是专业代工模式，专业的封测企业独立对外经营，接受芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封装服务，按封装量收取封装加工费。

公司为专业的封测服务提供商，经营模式为客户提供晶圆或芯片委托封装，公司根据客户订单制定月度生产任务与计划，待客户将需加工的晶圆发到公司后，公司自行采购原辅材料，由生产部门按照技术标准组织芯片封装与测试，封装完成及检验后再将芯片交还给客户，并向客户收取封装测试加工费。

销售方面，公司主要向芯片设计公司提供封装、测试和封测设计服务。芯片设计公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售。芯片设计公司完成芯片设计，交给晶圆代工厂（Foundry）制造晶圆芯片，晶圆芯片完工后交付公司，由公司组织进行芯片封装、测试，公司与客户建立合作关系时，签署委托加工框架合同，客户定期发送加工订单确定加工数量、价格等事项。

采购方面，公司采购部直接向国内外供应商采购生产所需原辅材料。具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划，并制定原材料采购计划与清单，采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购，并跟催物流交货进度，材料到货后由质保部门负责检验，检验合格后仓库入库并由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格。

(3) 行业情况说明：公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。

公司所处产业链主要包括芯片设计、晶圆制造与封装测试几个产业环节，同时还涉及相关材料与设备等支撑产业环节。产业以芯片设计为主导，由芯片设计公司设计出集成电路，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行芯片的封装、测试，最后销售给电子整机产品生产企业。对本公司而言，芯片设计企业委托公司进行封装加工，是公司的客户；材料等支撑企业为公司提供生产所需的原材料，是公司的供应商。

公司业务的上游是封装测试材料行业。上游原材料的供应影响封测行业的生产，原材料价格

的波动影响封测行业的成本。

公司业务的下游是芯片设计业。芯片设计产业环节的需求直接带动封测行业的销售增长，其需求的创新与不断变化也会推动封测行业技术工艺的变化和创新。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	3,733,560,121.10	2,307,776,795.90	61.78	2,272,198,541.26
营业收入	1,103,528,757.63	560,367,354.58	96.93	566,233,702.35
归属于上市公司股东的净利润	381,616,747.13	108,304,952.46	252.35	71,124,803.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,030,373.54	65,644,204.67	401.23	24,641,362.06
归属于上市公司股东的净资产	3,364,464,020.49	1,985,304,226.27	69.47	1,883,319,656.49
经营活动产生的现金流量净额	483,912,740.44	133,527,705.05	262.41	292,157,470.13
基本每股收益 (元/股)	1.19	0.33	260.61	0.31
稀释每股收益 (元/股)	1.19	0.33	260.61	0.31
加权平均净资产收益率(%)	17.62	5.61	增加12.01个百分点	3.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	190,664,034.79	264,325,086.21	309,226,662.28	339,312,974.35
归属于上市公司股东的净利润	62,113,482.86	93,943,656.38	112,065,275.80	113,494,332.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,489,378.97	76,579,842.14	95,534,585.40	104,426,567.03
经营活动产生的现金流量净额	83,612,318.45	82,282,373.99	137,575,672.04	180,442,375.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					91,057		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					82,901		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中新创投	22,019,311	77,067,587	23.97		无		国有法 人
大基金	5,455,624	27,133,377	8.44		无		国有法 人
EIPAT	-5,311,606	21,598,031	6.72		无		境外法 人
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	8,017,510	12,000,000	3.73		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	11,145,824	11,145,824	3.47		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	5,967,228	5,967,228	1.86		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	-1,292,071	4,462,568	1.39		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	1,131,720	3,961,020	1.23		未知		未知
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,453,686	2,775,186	0.86		未知		未知
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式	2,276,397	2,276,397	0.71		未知		未知

指数证券投资基金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 110,352.88 万元，同比上升 96.93%，实现营业利润 43,289.58 万元，同比上升 285%，实现净利 38,161.67 万元，同比上升 252%。分季度来看，第一季度实现销售收入 19,066.40 万元，净利 6,211.35 万元，第二季度实现销售收入 26,432.51 万元，净利 9,394.37 万元，第三季度实现销售收入 30,922.67 万元，净利 11,206.53 万元，第四季度实现销售收入 33,931.30 万元，净利 11,349.43 万元，单季度营收及利润规模均呈现持续增长的态势。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	晶方半导体科技（北美）有限公司	晶方北美	100	—

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。